

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁵ C08K 7/04	(11) 공개번호 특 1994-0019782	(43) 공개일자 1994년 09월 15일
(21) 출원번호	특 1994-0002907	
(22) 출원일자	1994년 02월 18일	
(30) 우선권주장	8/019,524 1993년 02월 19일 미국(US)	
(71) 출원인	렐프 윌슨 플라스틱 캄파니 리차드 알.하우탈라 미합중국 76503-6110 텍사스주 템플 피. 오. 박스 6110 제너럴 브루스 드라 이브 600	
(72) 발명자	피터 씨.가 미합중국 76502 텍사스주 템플 매그놀리아 블러바드 3410 베스 에이.라브로커 미합중국 76501 텍사스주 템플 박스 263 루트 4	
(74) 대리인	김성택, 주성민	

심사청구 : 없음

(54) 결정성 열가소성 칩을 함유한 잡색 광물 외관을 갖는 성형품

요약

본 발명은 잡색 광물의 외관을 갖는 성형품을 제조하기 위하여 충전된 합성 수지 매트릭스에 충전된 결정성 열가소성 수지 칩을 배합하는 것에 관한 것이다. 규칙적으로 충전된 폴리프탈아미드 수지 칩은 네 오픈셀 글리콜/이소프탈산 폴리에스테르 성형품의 표면 경도를 증가시키고 ASTM E 84 매연 지수를 저하시킨다. 결정성 열가소성 수지는 여러가지 형태의 칩을 제공하도록 각종 형태로 입출시킬 수 있다.

명세서

[발명의 명칭]

결정성 열가소성 칩을 함유한 잡색 광물 외관을 갖는 성형품

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

(57) 청구의 범위

청구항 1

(a)연속상 합성 수지 매트릭스 ; (b)성형품의 중량을 기준하여, 합성 수지 매트릭스와 실질적으로 동일한 굴절률을 갖고 평균 입도가 약 50 μ 미만인 무기입자 약 50중량% 이상 ; 및 (c)성형품에 잡색 외관을 부여하기에 충분한 양의 무기 입자로 충전된 결정성 열가소성 수지 칩으로 이루어지고, 이 칩은 연속상의 결정성 열가소성 수지 매트릭스 및 칩 중량의 약 50%의 무기 입자로 이루어진 것인 잡색 광물 외관을 갖는 합성 수지 성형품.

청구항 2

제1항에 있어서, 연속상의 결정성 열가소성 수지 매트릭스가 폴리알킬렌 테레프탈레이트, 폴리아미드, 폴리아미드-이미드, 폴리에스테르-이미드, 폴리아미드 및 폴레페닐렌설파이드 수지, 및 4,4'-디히드록시디페닐-p-히드록시벤조산 테레프탈산 중합체 및 이들의 혼합물로 이루어지는 군 중에서 선택된 것은 잡색 광물 외관을 갖는 합성 수지 성형품.

청구항 3

제1항에 있어서, 폴리아미드 수지가 폴리프탈아미드 수지인 것이 잡색 광물외관을 갖는 합성 수지 성형품.

청구항 4

제1항에 있어서, 무기 입자가 유리, 마이카 또는 규회석(wallastonite)의 섬유상 또는 플레이크상 입자 및 이들의 혼합물로 이루어지는 군 중에서 선택된 것인 잡색 광물 외관을 갖는 합성 수지 성형품.

청구항 5

제1항에 있어서, 무기 입자가 약 3 이상의 평균 종횡비를 갖는 규회석 입자인 것인 잡색 광물 외관을 갖

는 합성 수지 성형품.

청구항 6

제1항에 있어서, 상기 칩이 칩의 약 60중량% 이상의 약 5 이상의 평균 종횡비를 갖는 규회석 입자로 충전된 폴리프탈아미드 수지로 이루어진 것인 잡색 광물 외관을 갖는 합성 수지 성형품.

청구항 7

제6항에 있어서, 규회석 입자의 약 98중량% 이상이 약 40 μ 미만의 입도를 갖는 것인 잡색 광물 외관을 갖는 합성 수지 성형품.

청구항 8

제1항에 있어서, 성형품의 약 2중량% 이상이 충전된 결정성 열가소성 수지칩으로 구성된 것인 잡색 광물 외관을 갖는 합성 수지 성형품.

청구항 9

제1항에 있어서, 성형품의 약 2-15중량% 이상이 충전된 결정성 열가소성 수지 칩으로 구성된 것인 잡색 광물 외관을 갖는 합성 수지 성형품.

청구항 10

제1항에 있어서, 결정성 열가소성 수지 칩이 약 50-3,000 μ 의 입도를 갖는 것인 잡색 광물 외관을 갖는 합성 수지 성형품.

청구항 11

제1항에 있어서, 충전된 결정성 열가소성 수지 칩이 여러가지 형태를 갖는 것인 잡색 광물 외관을 갖는 합성 수지 성형품.

청구항 12

(a)성형품의 중량을 기준으로 약 50 μ 미만의 평균 입도를 갖는 알루미나 3수화물 입자 약 50중량% 이상으로 충전된 연속상의 불포화 폴리에스테르 수지 매트릭스 ; 및 (b)성형품에 잡색 광물 외관을 부여하기에 충분한 양의 규회석으로 충전된 폴리프탈아미드 수지 칩으로 이루어지고, 이 규회석은 칩 중량의 약 50중량% 이상을 구성하며 규회석 입자의 평균 종횡비는 약 3 이상인 것인 잡색 광물 외관을 갖는 합성 수지 성형품.

청구항 13

제12항에 있어서, 성형품의 약 2중량% 이상이 충전된 폴리프탈아미드 수지 칩으로 구성된 것인 잡색 광물 외관을 갖는 합성 수지 성형품.

청구항 14

제12항에 있어서, 성형품의 약 2-15중량% 이상의 충전된 폴리프탈아미드 수지 칩으로 구성된 것인 잡색 광물 외관을 갖는 합성 수지 성형품.

청구항 15

제12항에 있어서, 상기 칩이 약 50-3,000 μ 의 입도를 갖는 것인 잡색 광물 외관을 갖는 합성 수지 성형품.

청구항 16

(a)성형품의 중량을 기준으로 약 50 μ 미만의 평균 입도를 갖는 알루미나 3수화물 입자 약 60중량% 이상으로 충전된 연속상으로 네오펜틸 글리콜/이소프로탄산 폴리에스테르 수지 매트릭스 ; 및 (b)성형품에 잡색 광물 외관을 부여하기에 충분한 양의 규회석으로 충전된 폴리프탈아미드 수지 칩으로 이루어지고, 이 규회석은 칩 중량의 약 60중량% 이상을 구성하며 규회석 입자의 평균 종횡비는 약 5 이상인 것인 잡색 광물 외관을 갖는 합성 수지 성형품.

청구항 17

제16항에 있어서, 충전된 폴리프탈아미드 수지 칩이 약 50-3,000 μ 의 입도를 갖는 것인 잡색 광물 외관을 갖는 합성 수지 성형품.

청구항 18

제16항에 있어서, 성형품의 약 2중량% 이상이 충전된 폴리프탈아미드 수지 칩으로 구성된 것인 잡색 광물 외관을 갖는 합성 수지 성형품.

청구항 19

제16항에 있어서 성형품의 약 2-15중량%가 충전된 폴리프탈아미드 수지 칩으로 구성된 것인 잡색 광물 외관을 갖는 합성 수지 성형품.

청구항 20

제16항에 있어서, 충전된 폴리프탈아미드 수지 칩이 여러가지 형태를 갖는 것인 잡색 광물 외관을 갖는 합성 수지 성형품.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.